



*December. 28, 2016*

**TAIEX : 8070**

*CWE Commit to Total Excellence*

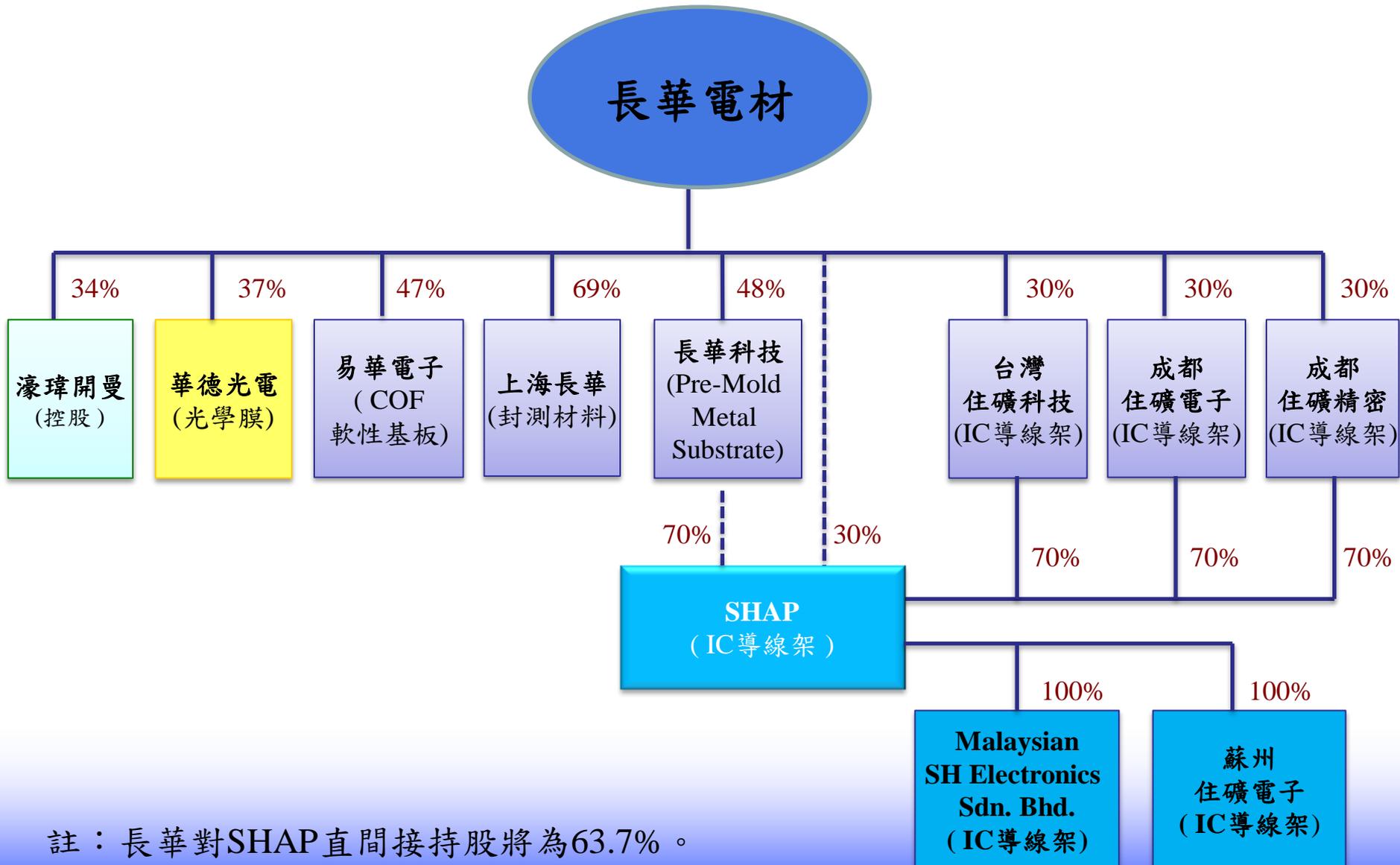
# 大綱

- 一、公司簡介
- 二、營運績效
- 三、購併SHAP綜效
- 四、全球半導體封裝材料趨勢
- 五、集團之策略佈局與發展規劃

# 一、公司簡介

設立日期	1989年5月13日
董事長	黃嘉能
總經理	葉錕溢
實收資本額	新台幣6.39億元
員工人數	79人(單一) 248人(合併)
總公司地址	高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓

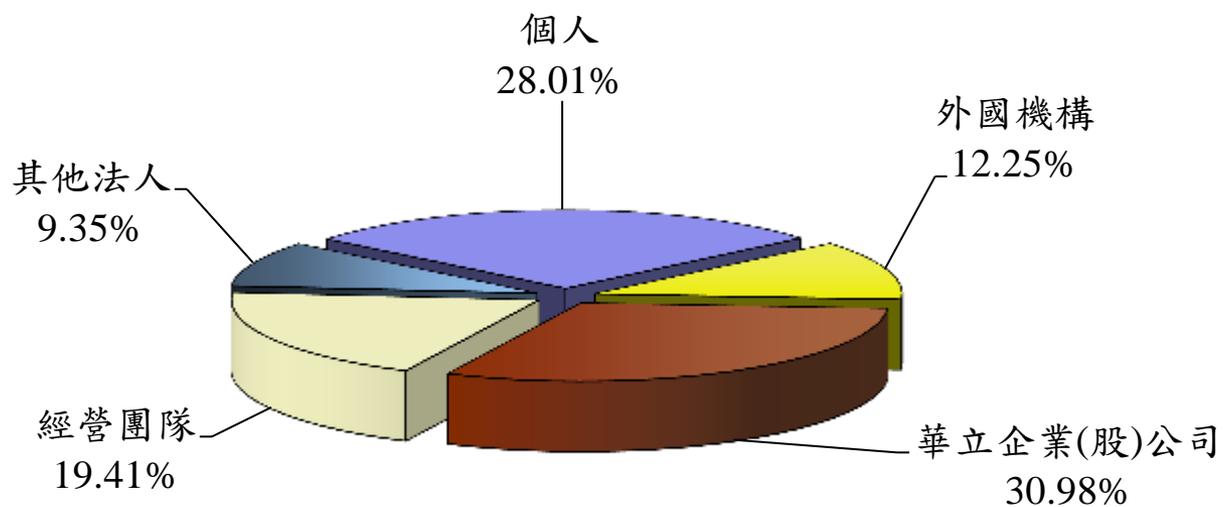
# 主要轉投資架構圖



註：長華對SHAP直間接持股將為63.7%。

產業別	主要商品	國內市場佔有率
IC封裝材料代理	封膠樹脂 (EME)	64%
	導電膠(銀膠)及非導電膠 (CRM)	37%
	導線架 (Lead Frame)	30%
	自動模壓設備 (Auto Molding Equipment)	35%
	去渣成型設備 (Trim & Form Equipment)	80%
IC封裝基板製造	Metal Substrate (Premold)	? %
	Organic Substrate	? %

## 股東結構(2016.06)



# 歷年獲利及股利



新台幣：元	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
稅後EPS	7.06	14.00	0.29	9.34	5.89	5.29	13.57
股票股利	0.00	0.30	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00
現金股利	6.00	9.70	0.60	3.00	3.10	3.50	7.00
合計股利	6.00	10.00	0.89	3.30	3.10	3.50	7.00
股利發放率	85%	71%	307%	35%	53%	66%	52%

註：2014 → 2015處分JMC

## 二、營運績效

# 2016年3Q營運績效(合併)



TD百萬元	2016年第三季		2015年第三季		變動率	2016年第二季		變動率
	金額	%	金額	%	%	金額	%	%
營業收入	2,434	100.0	3,557	100.0	(31.6)	2,674	100.0	(9.0)
銷貨成本	2,243	92.2	3,186	89.6	(29.6)	2,428	90.8	(7.6)
營業毛利	191	7.8	371	10.4	(48.5)	246	9.2	(22.4)
營業費用	98	4.0	349	9.8	(71.8)	125	4.7	(21.1)
營業淨利	93	3.8	22	0.6	324.9	122	4.5	(23.8)
營業外損益	97	4.0	28	0.8	241.6	21	0.8	370.2
繼續營業單位稅前淨利	189	7.8	50	1.4	277.8	142	5.3	33.2
所得稅費用	28	1.2	(1)	(0.0)	-	55	2.1	(48.2)
繼續營業單位本期淨利	161	6.6	51	1.4	213.5	87	3.3	84.3
停業單位損失	0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0
本期淨利	161	6.6	51	1.4	213.5	87	3.3	84.3
淨利歸屬於本公司業主	152		52		189.8	91		67.8
淨利歸屬於非控制權益	9		(1)		-	(3)		-
每股盈餘(元)-稅後	2.25		0.68			1.28		

註：累計2016年前三季稅後淨利為6.64億元，稅後EPS為9.51元。

# 2012~2016年3Q資產負債表摘要(合併)



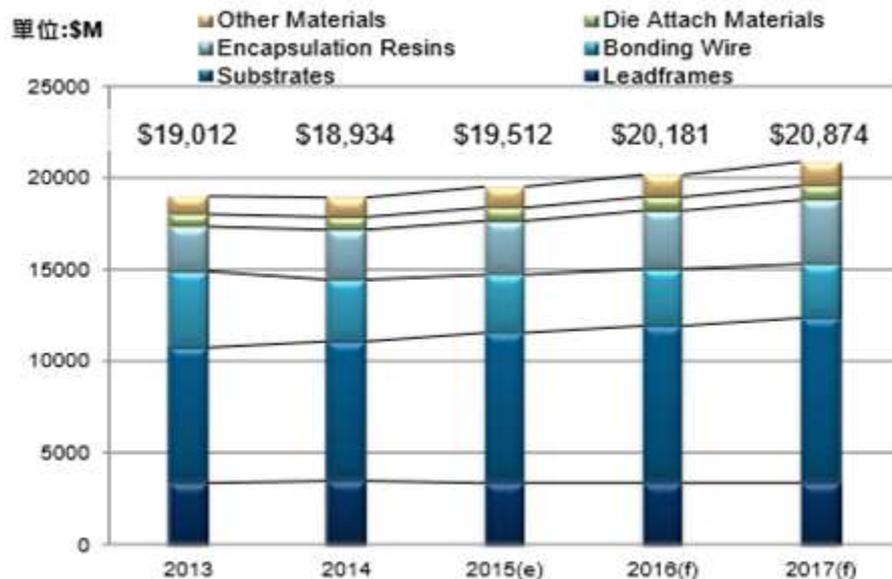
單位：NTD百萬元	2012.12.31 (IFRSs)	2013.12.31 (IFRSs)	2014.12.31 (IFRSs)	2015.12.31 (IFRSs)	2016.9.30 (IFRSs)
現金及短期投資	1,509	1,144	1,241	1,427	1,334
應收帳款	4,130	4,778	4,925	4,294	2,470
流動資產	7,267	7,746	8,441	7,828	4,832
長期投資	735	1,116	1,125	2,408	3,446
流動負債	4,781	5,211	5,658	5,038	3,332
長期負債	1,096	1,417	2,184	1,972	-
權益總計	4,562	5,632	6,257	6,721	5,720
總資產	10,680	12,482	14,340	13,966	9,235
每股淨值(元)	53.93	56.15	59.30	67.31	79.67
流動比率	152%	149%	149%	155%	145%
負債比率	57%	55%	56%	52%	38%

## 三、購併SHAP綜效

長華擬出資日幣45億元(折合新台幣約13.5億元)取得SHM(住友金屬礦山SMM子公司)旗下轉投資公司SHAP 30%股權

- 合併營收：待2017年3月31日完成股權交割，長華科因持有70%SHAP股權，將於股權交割後翌日開始認列100%SHAP營收，而長華合併營收亦將100%認列長華科營收。
- 獲利：長華因直接持有30%SHAP股權，透過持有長華科48%股權，又間接持有33.7%，故最終可以列63.7%SHAP獲利。

## 四、全球半導體封裝材料趨勢

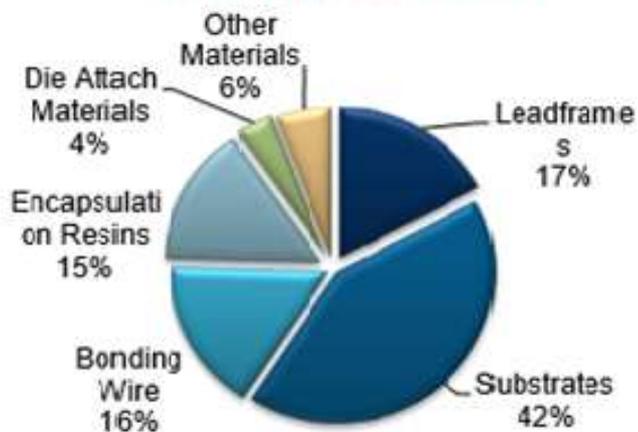


- \* 2015年總體構裝材料市場規模比起2014年略為成長 3.0%，達195.1億美元，預估2016年仍保持約3.4%的微幅成長，達201.8億美元
- \* IC載板仍是構裝主要材料，比重隨著總體需求而增減
- \* 導線架在QFN,QFP以及其他離散元件需求仍旺，但單價下跌之下市場規模微縮

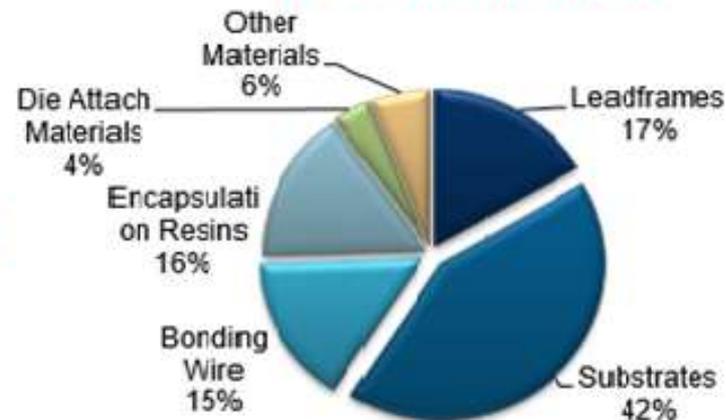


新技術(Premold)、新材料(PI Substrate)

2015年(e)195.1億美元



2016年(f)201.8億美元



## GLOBAL ORGANIC SUBSTRATE VOLUME MARKET DEMAND FORECAST

Laminate for IC Package Market Thousands of Square Meters	Actual		Forecast			
	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
Flip Chip BGA/LGA Substrates	2,544	2,637	2,741	2,893	3,045	4.60%
Flip Chip CSP Substrates	801	846	791	757	790	2.00%
Wire Bond PBGA Substrates	1,303	1,303	1,284	1,284	1,269	-2.10%
Wire Bond CSP Substrates	3,186	3,301	3,405	3,559	3,777	3.70%
<b>Total in K Square Meters</b>	<b>7,834</b>	<b>8,087</b>	<b>8,221</b>	<b>8,493</b>	<b>8,881</b>	<b>2.90%</b>
CAGR : Compound annual growth rate		Source : TechSearch International Inc., December 2015				

1. 市調單位預估全球 Organic substrate 的需求量(Km<sup>2</sup>)從2016~2019 約有2.9%的年複合成長率，顯示Organic substrate 仍處於緩步成長。
2. Flip chip的CAGR以4.6% 最高，以Wire Bond PBGA的-2.1%需求最低，原因是消費性產品對Organic substrate 的要求以細線路、薄型化為主流。這也在Wire Bond CSP substrate CAGR 3.7%得到呼應。
3. 以易華電子所具備之超細線路技術能力足以跨入此高端市場。

# Flip Chip Organic Substrate Features

Flip chip substrate	Via Fabrication Method		Via / Pad (um)		Min. Line/Space (um)	
	Build up (Core less)	Core	Build up (Core less)	Core	Build up (Core less)	Core
Production	Laser	Laser / Mech.	30/60~60/86	80/120~180/270	8/8 ~12/12	25/25~60/60

Source : TechSearch International Inc., December 2015

# 金屬導線架之市場分析

## GLOBAL LEADFRAME FORECAST

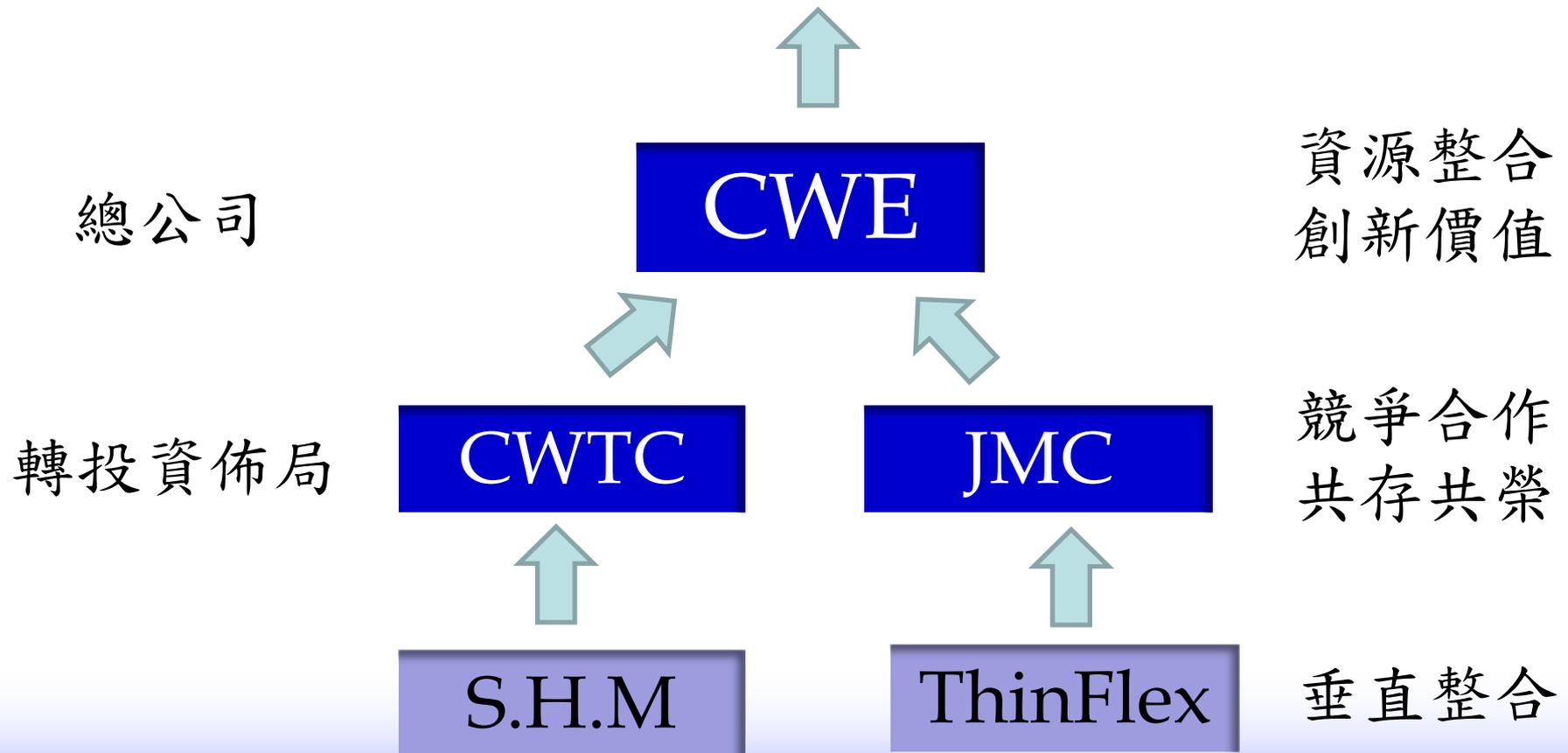
By Year	2015	2016	2017	2018	2019
Total Lead Frame Market ( Million USD)	2,991 M	3,001 M	3,037 M	3,042 M	3,020 M
Billion Units	650.8 B	676.6 B	712.2 B	740.6 B	766.5 B

Source : SEMI Industry Research

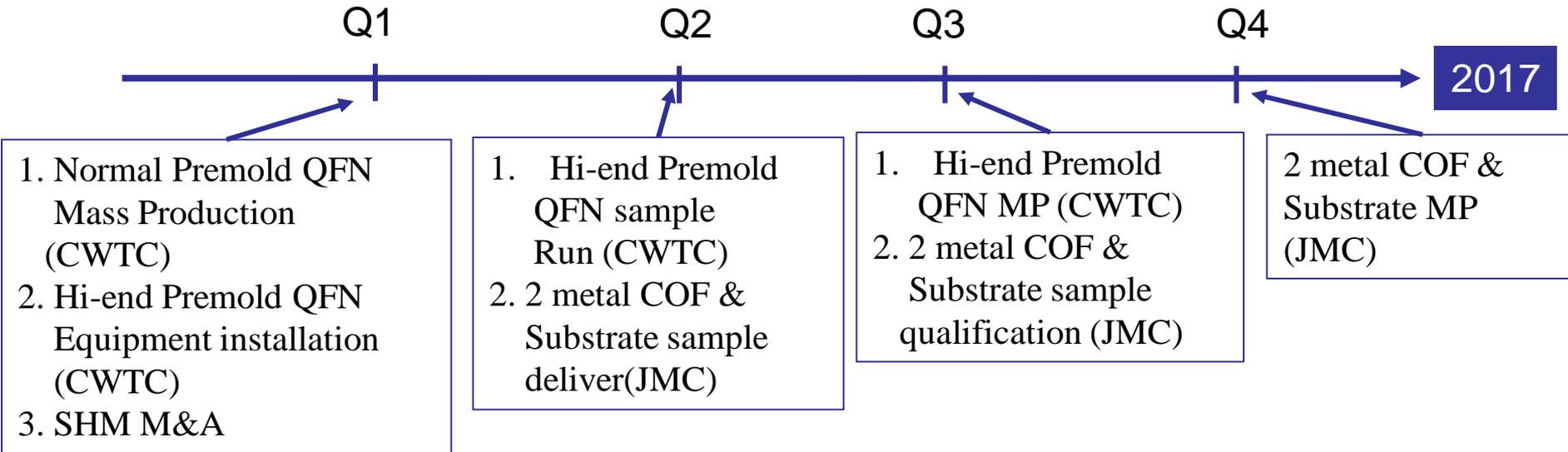
依據SEMI Industry research 的調查，未來三年(2017~2019)  
，金屬導線架的整體總量需求將呈現溫和成長。

# 五、集團之策略佈局與發展規劃

晉升為全球IC基板主要供應商之一



# 2017年主要里程碑



晉升為全球IC基板主要供應商之一

**Thank You**